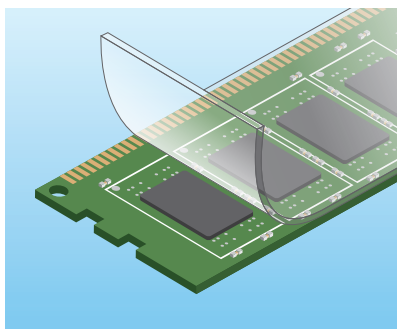


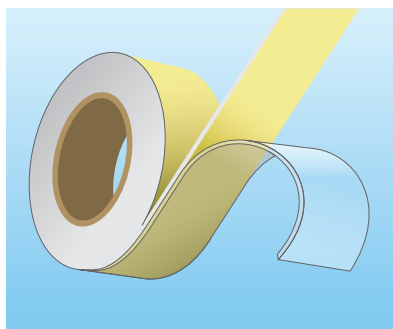
低・非シリコン系 離型フィルム

環境性能を高めた
離型フィルムの新基軸

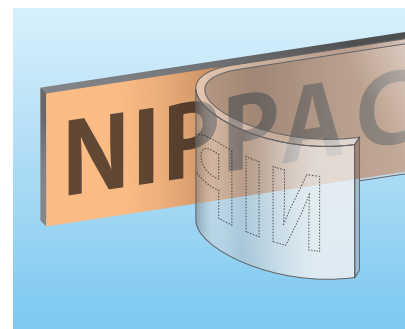
用途



電子部品製造工程用

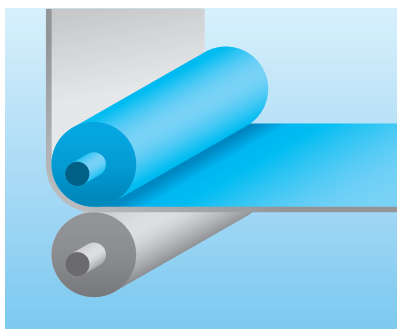


粘着テープ用



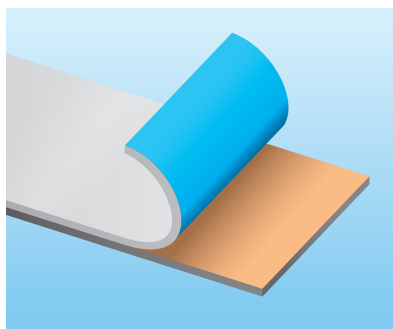
転写用

特徴



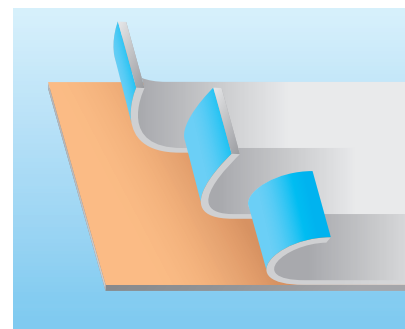
濡れ性・平滑性

優れた樹脂塗工性



離型性

シリコン系粘着剤に対しても有用



剥離安定性

軽～重剥離まで幅広いバリエーション

NIPPA Quality ニッパの強み

- 様々な基材厚みに対応可能。(一部のグレードは帯電防止処理も可能)
- 大手メーカーでは難しい小ロット対応可能。
- ご要望に合わせたカスタム対応可能。

製品データ

低・非シリコン系では難しいとされていた幅広い剥離バリエーションを実現。

■ 低シリコンタイプ

グレード	剥離力 (mN)	残留接着率 (%)	接触角 (°)
	日東31B		純水
SDL	130	94	104
LS1	80	94	117
LS2	60	93	115
LS3	50	93	114

■ 非シリコンタイプ

グレード	剥離力 (mN)	残留接着率 (%)	接触角 (°)
	日東31B		純水
TR	310	94	85
SFL	680	93	104
TM0	2500	96	89
TM4	3300	94	72
TM7	6300	96	69
TM10	11600	92	60

測定方法

剥離力	日東電工31B (50mm幅) を貼り合わせ、常温初期にて180°・300mm/minにてピール測定。
残留接着率	日東電工31B (50mm幅) を貼りつけ、常温放置1時間後測定。 $\frac{\text{セパレーターに貼り付けていたテープの粘着力}}{\text{テフロン板に貼り付けていたテープの粘着力}} \times 100$
水接触角	JIS R3257準拠